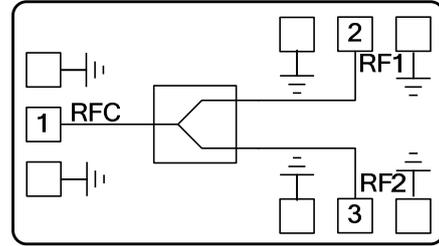




主要特点

- 频率范围: DC - 40 GHz
- 插入损耗: 3.0 dB
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.0 × 0.5 × 0.1 mm³

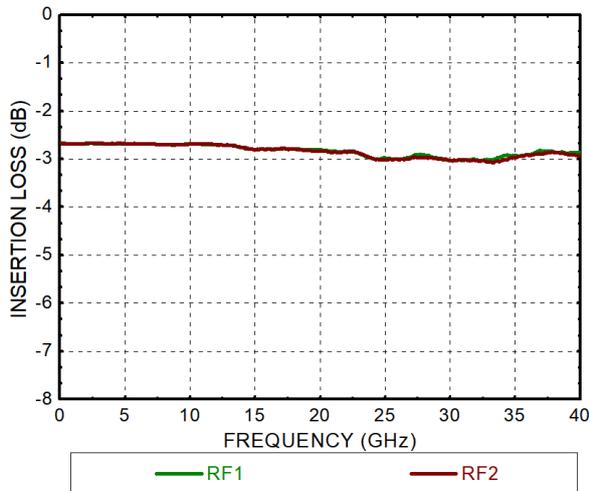
功能框图



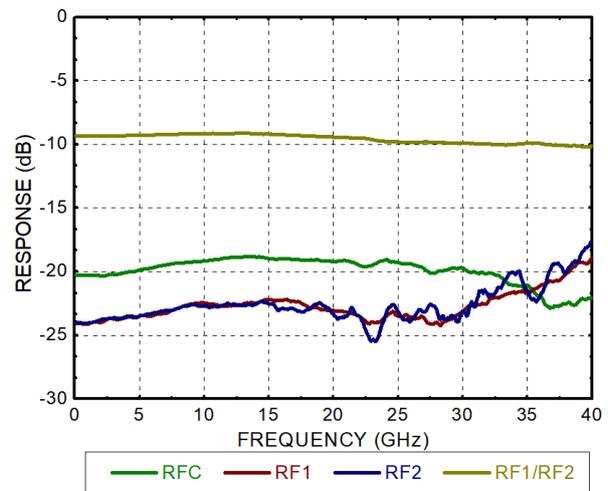
性能指标 ($T_A = +25\text{ }^\circ\text{C}$, $P_{in} = 0\text{ dBm}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC - 40			GHz
插入损耗 (扣除功分欧姆损耗)		3.0		dB
平坦度		±0.2		dB
隔离度		10		dB
回波损耗		20		dB

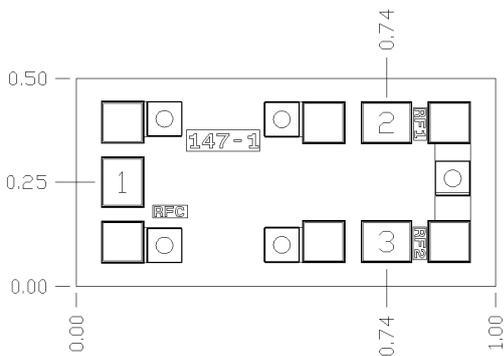
插入损耗



隔离度与回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RFC	该焊盘是射频公共端
2	RF1	该焊盘是射频支路端
3	RF2	该焊盘是射频支路端



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件, 运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN+PBO; 厚度: $0.5+1.6\mu\text{m}$

极限参数

1. 射频输入功率: +34 dBm
2. 储存温度: $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
3. 工作温度: $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$